

2024年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年5月15日

上場会社名 ウインテスト株式会社
コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 姜 輝
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康
四半期報告書提出予定日 2024年5月15日
配当支払開始予定日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

1. 2024年12月期第1四半期の連結業績(2024年1月1日~2024年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期第1四半期	211	156.7	71		45		46	
2023年12月期第1四半期	82	59.8	131		138		139	

(注) 包括利益 2024年12月期第1四半期 32百万円 (%) 2023年12月期第1四半期 114百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年12月期第1四半期	1.07	
2023年12月期第1四半期	3.75	

2024年12月期第1四半期及び2023年12月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年12月期第1四半期	2,129	1,632	76.2
2023年12月期	1,973	1,665	83.9

(参考) 自己資本 2024年12月期第1四半期 1,623百万円 2023年12月期 1,655百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年12月期		0.00		0.00	0.00
2024年12月期					
2024年12月期(予想)		0.00		0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日~2024年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計) 通期									

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2024年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。詳細については、添付資料P3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年12月期1Q	43,641,000 株	2023年12月期	43,641,000 株
期末自己株式数	2024年12月期1Q	株	2023年12月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年12月期1Q	43,641,000 株	2023年12月期1Q	37,077,650 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(会計方針の変更)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	10
3. その他	11
継続企業の前提に関する重要事象等	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間（2024年1月1日～2024年3月31日）における世界経済成長率は、IMF（アイ・エム・エフ、国際通貨基金）によると3.1%前後と数十年ぶりの低成長率と見積もられていますが、インフレ率は、2024年で5.9%程度であり、2025年は4.5%と想定されていることから安定的に鈍化の傾向であると言われております。しかし長引くロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの紛争が発生、イラン、米国をも巻き込むなど更に混迷を深めており、更に兼ねてより大きな懸念となっている米中間の半導体をめぐる台湾を挟んでの対立など、世界情勢の見通しは再び不透明さを増しております。このような中、IMFでは先進国の2024年の成長率を1.7%程度、2025年は1.8%前後と見込んでおりますが（2024年4月発表）、しかし上述の世界情勢の不安定さが、先進国の成長率を相殺するとの懸念も出ており、予断を許さない状況が続いております。

当第1四半期における我が国経済に目を向けると、日銀短観では、2024年は、「マイナス金利」の政策転換、利上げを継続的に計画し、政策金利の誘導目標を0～0.1%程度に引き上げることを決定していますが、数十年ぶりと言われる円安を記録するなど、企業活動や市民生活の下振れ不安は拭いきれない状況です。特に電気・石油・ガスなどエネルギー価格の高騰が大きく影響し、多方面に大きな影響が出ており、デフレ終息が期待されるも消費の低迷を招く恐れがあります。一部サービス品目は伸びているとしているが、極端な円安は、原材料高を引起し我が国経済を直撃、製造業を中心に景況感が低迷する懸念が叫ばれています。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界におきましては、2023年に起こった世界的な巣ごもり需要の減少を背景に、民生品向け半導体やフラットパネルディスプレイの需要が急減、在庫がダブつく事態となり、最終製品の出荷数量も、PCモニターやノートPC、スマートフォンなどを中心に全体の数量として大きく減少しました。その結果、多くの半導体工場は、工場の稼働率を下げる動きが目立ち、それに伴い新規設備投資凍結を行いました。米Bloombergの調査によると、当第1四半期には徐々に半導体在庫も正常値と言われる3か月程度となり、慎重さはみられるものの半導体工場の稼働率も上がってきており、下半期には急激に回復するといわれています。台湾の半導体・FPD市場動向調査会社であるTrendForce社の調査によると、2024年の特徴として、主に生成AI分野の急成長に引っ張られる形で関連するDRAM及びNAND、そしてパネル等の需要が増え、車載、AR/VR、パブリックディスプレイなどの新規アプリの需要も大きく回復するであろうと言われております。また今後の半導体市場の10年は、上述の生成AI向けデータセンターやGX投資（グリーン投資）など、官民両輪によるインフラの整備が牽引役となり、力強く成長すると見られております。

このような環境下、当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、2023年に営業を中心として顧客チャンネル構築、お客様新デザインICチップ向けベンチマークの積極的引受けを行い、ブランド戦略を取ってまいりました。その結果、中国、台湾のディスプレイ・ドライバーIC等のデザインハウスやOSAT各社経営陣からの直接訪問を頂けました。また、中国における各社半導体工場の新設に合わせたお引合いを頂けることとなり、2024年下半期における設備投資意欲の上向き予測に向け社内の体制を整えております。開発方面では、引続き現地の顧客ニーズに適合したディスプレイ・ドライバーIC検査装置や、次世代検査ユニットなどの開発を継続しています。

また、営業面では販売店に集中させていた、販売方法を見直し当社の製造子会社の営業を含めた直接販売を拡大することとし、現地マーケットに集中した営業展開を行っております。当第1四半期連結累計期間においては、上述のように、新規設備投資に関するお引き合いはあるものの、依然慎重な姿勢が強く、本格投資は第2四半期以降になるものと予測しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は211,959千円（前年同四半期比156.7%増）、営業損失71,113千円（前年同四半期は営業損失131,890千円）、経常損失45,983千円（前年同四半期は経常損失138,499千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失46,602千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失139,119千円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ156,000千円増加し、2,105,076千円（前連結会計年度末比8.0%増）となりました。この主な要因は、現金及び預金が156,223千円増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ163千円減少し、24,425千円（前連結会計年度末比0.7%減）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が163千円減少したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ196,283千円増加し、361,114千円（前連結会計年度末比119.1%増）となりました。この主な要因は、短期借入金が増加したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ8,034千円減少し、135,616千円（前連結会計年度末比5.6%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が増加したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ32,411千円減少し、1,632,771千円（前連結会計年度末比2.0%減）となりました。この主な要因は、利益剰余金が46,602千円減少したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

前連結会計年度からの半導体工場各社における在庫調整及び新規設備投資の凍結という状況から回復しつつある市場は、当第1四半期中は、新規設備投資に慎重な企業が多く様子見が続いておりました。米Bloomberg社（2024年4月5日付）によると、第2四半期以降は、特に半導体製造工場が集中する中国において、在庫調整は底を打ち急加速するとみられており、今後中国各社の動きが活発化して行くものと考えております。一方で、第2四半期以降の半導体市場は、各国で声高に叫ばれている電気自動車（EV）は期待に反し大きく鈍化するとの観測もありますが、ChatGPTに代表される生成A.I.向けGPU（画像を含む高速情報処理チップ）などのハイエンド・ミックスデバイスや各国政府の進めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のさらなる進展、脱炭素化推進に向けたペーパーレス化、高齢化社会に向け期待の高まる自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しい世界（VRやメタバース）が急速に拡大し、各種クラウドデータセンターは勿論、GX投資（グリーン投資）など、官民連携によるインフラの整備がけん引役となり、力強く成長すると見られております（Techinsight）。また、同社によると、今後の10年の半導体市場では、これまでスマートフォン、PCや情報端末が占めていたニーズは、将来的に産業用途・医療・自動車向けのものに変わるものと予想されています。

近年の半導体の複雑化や集積度向上（例、線幅4nmから2nm）は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体テスト市場は、装置能力の向上に加え装置台数の増加が期待される方向と考えております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるディスプレイ・ドライバーIC検査装置は、液晶パネルに使われるディスプレイドライバーIC（ディスプレイに絵や文字を表示するIC）の検査に使用されており、また、それら情報機器ではディスプレイ・ドライバーICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。

当社の主力検査装置WTS-577SRにつきましては、当第1四半期連結累計期間において、当該装置に開発の完了した新規機能を搭載したハードウェアを順次搭載することで、顧客の新規開発の次世代ディスプレイ・ドライバーICのベンチマークを積極的に受け、複数の顧客から量産評価の完了と順次竣工予定の新工場への導入に向けた引合い協議を進めております。

今後、当社連結子会社ウインテスト武漢との協力体制強化を土台にして、さらに中国市場攻略を確実にするため、これまでの販売店に依存した営業戦略を見直し、販売店の営業チャンネルや人的チャンネルを有効に活用しながら、当社、営業、及び技術でタグを組み直接営業を行う戦略に代えてまいります。

先端ロジックIC検査装置（1024チャンネル、875Mbps）に関しては、国内・台湾・中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代ディスプレイ・ドライバー検査装置と共用することで、より広範囲のロジックIC検査に対応できるように計画し、協力企業と共に2024年末までにベンチマークを終了する予定です。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、2025年までに当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用しつつ外部専門会社からの協力のもと、今後の市場拡大が見込まれる5Gとその後の6G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーターひとりで簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指しております。さらに、ロボットを得意とする専門工場と協議し、2024年問題で揺れる「物流市場」におけるトラック向け荷役補助装置の製品化を考えており、ご協力いただける中小型トラック事業会社様を選定中です。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG、ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、現在特定のお客様への試験販売を継続しつつ同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し機能の強化を進めており、当面は病院、介護施設への試験販売を行っております。なお、個人家庭向け製品につきましては、機能面の見直しと量産体制が整い次第、お知らせいたします。

なお、2024年2月14日の「2023年12月期 決算短信」で公表いたしましたとおり、2024年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	361,665	517,888
売掛金	106,452	141,887
電子記録債権	2,433	—
商品及び製品	118,278	121,746
仕掛品	813,622	774,791
原材料及び貯蔵品	525,733	533,052
前渡金	4,094	1,611
未消費税等	5,561	5,954
その他	11,234	8,144
流動資産合計	1,949,076	2,105,076
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物(純額)	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具(純額)	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品(純額)	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	24,588	24,425
貸倒引当金	—	—
投資その他の資産合計	24,588	24,425
固定資産合計	24,588	24,425
資産合計	1,973,665	2,129,502

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	12,077	9,530
短期借入金	—	200,000
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
未払金	52,286	49,396
未払法人税等	13,959	5,266
賞与引当金	—	5,991
契約負債	3,303	19,044
製品保証引当金	552	—
その他	50,587	39,821
流動負債合計	164,831	361,114
固定負債		
長期借入金	136,966	128,950
リース債務	171	128
資産除去債務	6,513	6,537
固定負債合計	143,651	135,616
負債合計	308,482	496,730
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,627,193	1,627,193
資本剰余金	1,913,679	1,913,679
利益剰余金	△2,023,127	△2,069,730
株主資本合計	1,517,745	1,471,142
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	138,203	152,394
その他の包括利益累計額合計	138,203	152,394
新株予約権	9,234	9,234
純資産合計	1,665,183	1,632,771
負債純資産合計	1,973,665	2,129,502

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
売上高	82,583	211,959
売上原価	41,504	107,308
売上総利益	41,078	104,651
販売費及び一般管理費	172,969	175,764
営業損失(△)	△131,890	△71,113
営業外収益		
受取利息	11	49
為替差益	—	27,288
その他	590	300
営業外収益合計	601	27,638
営業外費用		
支払利息	2,540	2,094
為替差損	3,457	—
その他	1,212	413
営業外費用合計	7,210	2,508
経常損失(△)	△138,499	△45,983
税金等調整前四半期純損失(△)	△138,499	△45,983
法人税、住民税及び事業税	619	619
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	619	619
四半期純損失(△)	△139,119	△46,602
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△139,119	△46,602

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
四半期純損失 (△)	△139,119	△46,602
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	24,874	14,191
その他の包括利益合計	24,874	14,191
四半期包括利益	△114,244	△32,411
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△114,244	△32,411
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業に関する注記)

当社グループは前連結会計年度において、半導体製造工場の生産調整の影響から、売上高は407,449千円と回復基調にあるものの、営業損失は558,459千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を554,572千円計上しております。

前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の行動制限の影響で始まった巣ごもり需要が、行動制限解除により急激な終焉を迎えることとなり、民生半導体のダブつきが発生し、多くの半導体製造工場は、生産調整から新規設備投資を凍結しておりました。当第1四半期連結累計期間においては、生産調整は順次終了し、半導体の超過在庫も最悪の6か月超から3か月程度に改善、増産に舵を切り始めお客様からの装置お引き合いは増える方向となりました。当第1四半期の半導体製造会社の状況は、各社様子見の状況ですが、スマートフォンや情報端末の販売は緩やかな上昇は見られるもののまだ市場をけん引するほどの力強さは見られる状況ではなく、半導体製造工場各社は当社第2四半期、当社第3四半期に向けて増産の準備を始めている状況であり、増産に伴う設備投資も慎重さはあるものの上昇に向かいつつあると考えております。なお、2024年1月15日に受注いたしました装置の出荷売上は順調に進み当第1四半期末までに完了しております。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、211,959千円となり、前年同期比で156.7%の増加となりました。しかし、売上増となったものの、上述のような状況から赤字脱却までにはいたらず、営業損失71,113千円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は46,602千円を計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失を計上している状況にあり、当社グループには継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

上記のように、前連結会計年度からの半導体工場各社における在庫調整及び新規設備投資の凍結という状況から回復しつつある市場は、当第1四半期中は、新規設備投資に慎重な企業が多く様子見が続いておりました。米Bloomberg社(2024年4月5日付)によると、第2四半期以降は、特に半導体製造工場が集中する中国において、在庫調整は底を打ち急加速するとみられており、今後中国各社の動きが活発化して行くものと考えております。一方で、第2四半期以降の半導体市場は、各国で声高に叫ばれている電気自動車(EV)は期待に反し大きく鈍化すると観測もありますが、ChatGPTに代表される生成A.I.向けGPU(画像を含む高速情報処理チップ)などのハイエンド・ミックスデバイスや各国政府の進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)のさらなる進展、脱炭素化推進に向けたペーパーレス化、高齢化社会に向け期待の高まる自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しい世界(VRやメタバース)が急速に拡大し、各種クラウドデータセンターは勿論、GX投資(グリーン投資)など、官民連携によるインフラの整備がけん引役となり、力強く成長すると見られております(Techinsight)。また、同社によると、今後の10年の半導体市場では、これまでスマートフォン、PCや情報端末が占めていたニーズは、将来的に産業用途・医療・自動車向けのものに変わるものと予想されています。

近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体テスト市場は、装置能力の向上に加え装置台数の増加が期待される方向と考えております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるディスプレイ・ドライバーIC検査装置は、液晶パネルに使われるディスプレイドライバーIC(ディスプレイに絵や文字を表示するIC)の検査に使用されており、また、それら情報機器ではディスプレイ・ドライバーICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど多種にわたる周辺半導体デバイスが使われております。

当社の主力検査装置WTS-577SRにつきましては、当第1四半期連結累計期間において、当該装置に開発の完了した新規機能を搭載したハードウェアを順次搭載することで、顧客新規開発の次世代ディスプレイ・ドライバーICのベンチマークを積極的に受け、複数の顧客から量産評価の完了と順次竣工予定の新工場への導入に向けた引合い協議を進めております。

今後、当社連結子会社ウインテスト武漢との協力体制強化を土台にして、さらに中国市場攻略を確実にするため、これまでの販売店に依存した営業戦略を見直し、販売店の営業チャンネルや、人的チャンネルを有効に活用させて頂きながら、当社、営業、及び技術でタッグを組み直接営業を行う戦略に代えてまいります。

2. 技術開発の強化

先端ロジックIC検査装置(1024チャンネル、820Mbps)に関しては、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代ディスプレイ・ドライバー検査装置と共用することで、より広範囲のロジックIC検査に対応できるように計画し、協力企業と共に2024年度末までにベンチマークを終了する予定です。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、2025年までに当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用、しつつ外部専門会社からの協力のもと、今後の市場拡大が見込まれる5Gとその後の6G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

3. 隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーターひとりで簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指しております。さらに、ロボットを得意とする専門工場と協議し、2024年問題で揺れる「物流市場」におけるトラック向け荷役補助装置の製品化を考えており、ご協力いただける中小型トラック事業者様を選定中です。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、現在特定のお客様への試験販売を継続しつつ同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し機能の強化を進めており、当面は病院、介護施設への試験販売を行っております。なお、個人家庭向け製品につきましては、機能面の見直しと量産体制が整い次第、お知らせいたします。

財務施策

財務面については、前連結会計年度に行った新株予約権行使による資金調達で昨今の株価低迷により当初計画した調達予定額に達しなかったこと、及び売上及び入金の一部持ち越しとなったことから、財務基盤を強化する目的のため、2024年2月19日の取締役会の決議において、GFA株式会社を借入先とする1億円の借入を決議し、2024年2月26日に実行されております。また、同目的のため、2024年2月20日の取締役会の決議において、楽言海外国際(香港)有限公司を借入先とする1億円の借入を決議し、2024年2月20日、21日及び22日の3回に分けて実行されております。今後も、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、同社グループ及び金融機関からの借入、並びに資本増強等による資金確保についての施策を今後とも継続して実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でありますが、前述のようにアフターコロナ後の設備投資凍結からの半導体製造装置市場の復調は緩やかであり、当第1四半期における半導体各社の投資意欲は強いものの慎重さを含んでおり、米Bloomberg社、WSTS（世界半導体市場統計）による予想では、本格的な設備投資は第2四半期以降であるとされております。特に当社が当面、メイン市場とする中国、台湾市場における新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、市場が上向くと予想される第2四半期以降と考えております。

事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、前記の新株予約権による調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、半導体検査装置事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは前連結会計年度において、半導体製造工場の生産調整の影響から、売上高は407,449千円と回復基調にあるものの、営業損失は558,459千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を554,572千円計上しております。

前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の行動制限の影響で始まった巣ごもり需要が、行動制限解除により急激な終焉を迎えることとなり、民生半導体のダブつきが発生し、多くの半導体製造工場は、生産調整から新規設備投資を凍結しておりました。当第1四半期連結累計期間においては、生産調整は順次終了し、半導体の超過在庫も最悪の6か月超から3か月程度に改善、増産に舵を切り始めお客様からの装置お引き合いは増える方向となりました。当第1四半期の半導体製造会社の状況は、各社様子見の状況ですが、スマートフォンや情報端末の販売は緩やかな上昇は見られるもののまだ市場をけん引するほどの力強さは見られる状況ではなく、半導体製造工場各社は当社第2四半期、当社第3四半期に向けて増産の準備を始めている状況であり、増産に伴う設備投資も慎重さはあるものの上昇に向かいつつあると考えております。なお、2024年1月15日に受注いたしました装置の出荷売上は順調に進み当第1四半期末までに完了しております。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、211,959千円となり、前年同期比で156.7%の増加となりました。しかし、売上増となったものの、上述のような状況から赤字脱却までにはいたらず、営業損失71,113千円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は46,602千円を計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。